

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2021-024

木林森股份有限公司

关于对外担保进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

（一）本次担保情况概述

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）为了支持下属全资子公司吉安市木林森电子科技有限公司（以下简称“木林森电子”）及吉安市木林森半导体材料有限公司（以下简称“木林森半导体”）更好的开展生产，近日，公司、木林森电子、木林森半导体及晶宇光电（厦门）有限公司（以下简称“晶宇光电”）签订了《最高额保证合同》，公司同意为下属子公司木林森电子、木林森半导体与晶宇光电采购业务提供担保，担保金额为最高额 40,000 万元。

（二）担保审议情况

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司（含控股子公司）在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为人民币 200,000 万元。对外担保额度有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。董事会提请股东大会授权公司董事长孙清焕先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权孙清焕先生根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各下属公司的担保额度。上述事项已经 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于 2020 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-042）。

二、担保事项基本情况表

单位：万元

担保方	授权担保对象	本次被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前经审批可用担保总额度	本次使用担保额度	本次使用担保额度占公司最近一期净资产比例	剩余可用担保额度
木林森股份有限公司	资产负债率<70%的全资子公司	吉安市木林森电子科技有限公司	38.07%	1,260,000	40,000	3.87%	756,640.06
木林森股份有限公司	资产负债率>70%的全资子公司	吉安市木林森半导体材料有限公司	87.12%				

三、被担保人基本情况

(一) 吉安市木林森电子科技有限公司

- 1、公司名称：吉安市木林森电子科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360805MA35F0148B
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区
- 5、法定代表人：张建军
- 6、注册资本：1080万元
- 7、成立日期：2003年05月15日
- 8、经营范围：开发、生产、销售光电器件、组件及其它电子产品(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

9、股权架构：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	1080	100.00%
合计	1080	100.00%

10、近一年一期财务情况：

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	10,983.78	8,961.35
负债总额	4,182.04	5,499.09
所有者权益总额	6,801.74	3,462.26
项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日

营业收入	2,844.73	6,625.01
净利润	4,339.48	50.52

11、木林森电子不属于失信被执行人

(二) 吉安市木林森半导体材料有限公司

- 1、公司名称：吉安市木林森半导体材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360805MA38D76Q0E
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南塘路288号
- 5、法定代表人：陈江聪
- 6、注册资本：30000万元
- 7、成立日期：2019年02月27日
- 8、经营范围：半导体器件专用设备制造及材料生产、加工、销售、研发，
以上产品的进出口业务及其国内贸易。

9、股权架构：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
吉安市木林森实业有限公司	30000	100.00%
合计	30000	100.00%

注：吉安市木林森实业有限公司为公司的全资子公司

10、近一年一期财务情况：

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	83,017.85	45,760.16
负债总额	72,324.18	42,458.58
所有者权益总额	10,693.66	3,301.58
项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
营业收入	83,618.00	64,495.36
净利润	7,392.08	1,811.58

11、木林森半导体不属于失信被执行人

四、担保协议的主要内容

1、合同签署人：

甲方（供方）：晶宇光电（厦门）有限公司

乙方（保证方）：木林森股份有限公司

丙方（需方）：吉安市木林森电子科技有限公司

丁方：吉安市木林森半导体材料有限公司

2、主债权及最高额

(1)乙方自愿为丙方在 2021 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 15 日期间（即债权确定期间）内向甲方采购 LED 晶片所形成的所有债务（每一笔交易产生的每一笔债务）提供连带责任保证。

(2)2019 年，甲方与乙方下属子公司吉安市木林森半导体材料有限公司就采购 LED 晶片达成合作，现因吉安市木林森半导体材料有限公司的产业调整，故改为由丙方承接与甲方的交易。乙方自愿为吉安市木林森半导体材料有限公司在 2019 年 11 月 01 日至 2021 年 03 月 15 日期间（即债权确定期间）内向甲方采购 LED 晶片所形成的所有债务（每一笔交易产生的每一笔债务）提供连带责任保证。

(3)乙方对上述连带保证金额为最高额人民币 4 亿元。

3、保证范围

乙方提供保证担保的范围为丙方在本协议第一条约定的期间内和最高额范围内因向甲方采购 LED 晶片对甲方所形成的债务，包括：

(1)应付货款、利息、违约金；

(2)丙方未履行合同义务而给甲方造成的全部损失赔偿（直接损失和间接损失）；

(3)甲方实现上述第 1、第 2 项债权或主张权利而产生的全部费用（包括但不限于解决争议的诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、调查费等）；

(4)存在产品质量争议的债权债务，甲方与丙方应尽快协商以厘清争议原因，在该争议未厘清前，甲方不得径自要求乙方承担该笔争议金额的担保责任；如经确认因甲方提供的产品质量问题而存在争议的金额，应与甲方协商讨论确认方案方可执行。

4、保证方式及期间

(1) 乙方在本协议项下提供的保证为连带责任保证。

(2) 如果丙方转让其债务的，则乙方随之按照本协议的约定为该债务受让方向甲方承担连带责任保证。

(3) 保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年止。如甲方同意主债务延期，则相应的保证期间也顺延，但甲方、丙方应书面通知乙方，否则视为保证期间不顺延。

5、保证效力

本合同的效力独立于主合同，担保责任的效力或内容不因主合同或主债务的效力、内容或变更、变化而受到任何影响，如主合同被确认为不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销、被解除，则乙方对于丙方因返还财产或赔偿损失而形成的债务承担连带责任。主债务或主合同的任何变更、变化须书面通知乙方，若甲方、丙方未履行通知义务的，则甲方有权拒绝就主债务或主合同的任何变更、变化承担保证责任。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为 0 元，公司对子公司累计担保金额为 463,359.94 万元，占公司 2019 年经审计合并报表净资产比例为 44.82%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日